

Однако компания столкнулась с трудностями в обеспечении своих процессоров 5G-модемами. После отказа Qualcomm от поставок, Xiaomi обратилась к MediaTek, которая согласилась предоставить свои модемы для нового чипа.

Ранее сообщалось, что Xiaomi разрабатывает 3-нм чип совместно с MediaTek, а производством займется TSMC.

Это сотрудничество позволит Xiaomi интегрировать 5G-модемы разработчиков Dimensity и Helio в свои устройства, обеспечивая высокую производительность и соответствие современным стандартам связи.

Ожидается, что новый чипсет будет конкурировать с флагманскими решениями от Qualcomm и самой MediaTek, такими как Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400.